

利欧集团股份有限公司

关于对外投资设立 IGBT 项目合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）及全资子公司福建平潭元初投资有限公司（以下简称“平潭元初”）与上海众挺智能科技有限公司（以下简称“众挺智能”）就 IGBT 芯片及模组生产项目以合资公司的形式开展合作。

合资公司拟引进的核心研发、技术及管理团队以入伙的方式进入持股平台并通过有限合伙企业间接持有合资公司股权。平潭元初与持股平台投资设立合资公司，其中平潭元初持股 0.01%，持股平台持股 99.99%。

合资公司设立后，利欧股份、众挺智能分别以货币形式向合资公司增资，其中，利欧股份出资人民币 5,100 万元，众挺智能出资人民币 2,900 万元。增资完成后，利欧股份持股占合资公司注册资本的 51%；众挺智能持股占合资公司注册资本的 29%；平潭元初与持股平台合计持股占合资公司注册资本的 20%。

有关内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资设立 IGBT 项目合资公司的公告》（公告编号：2020-086）。

二、对外投资进展情况

近日，合资公司已完成相应的工商登记手续，并于 2020 年 11 月 9 日取得了营业执照。相关的工商登记信息如下：

- 1、公司名称：上海狮门半导体有限公司
- 2、注册资本：人民币 1000 万元。

3、成立日期：2020年9月23日

4、法定代表人：王相荣

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、统一社会信用代码：91310117MA1J4LXU0D

7、住所：上海市松江区中辰路299号1幢617室

8、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体电子元器件、集成电路及电子零部件、电子专用材料制造、设计、研发及销售，软件开发，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、合资公司股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例
1	利欧集团股份有限公司	510	51%
2	上海众挺智能科技有限公司	290	29%
3	福建平潭瑞辰投资咨询合伙企业(有限合伙)	199.98	19.998%
4	福建平潭元初投资有限公司	0.02	0.002%
合计		1,000	100%

利欧股份出资人民币5,100万元认缴合资公司510万元出资额（对应合资公司注册资本总额的51%），其中510万元计入实收资本，超出实收资本部分的其余4,590万元作为出资溢价计入资本公积；

众挺智能出资人民币2,900万元认缴合资公司290万元出资额（对应合资公司注册资本总额的29%），其中290万元计入实收资本，超出实收资本部分的其余2,610万元作为出资溢价计入资本公积。

福建平潭元初投资有限公司持有的合资公司股权将全部转让给持股平台福建平潭瑞辰投资咨询合伙企业(有限合伙)。转让完成后，福建平潭瑞辰投资咨询合伙企业(有限合伙)持有合资公司20%的股权。

公司将持续关注合资公司的经营状况及相关事项进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年11月10日